

证券代码：688099

证券简称：晶晨股份

公告编号：2025-058

晶晨半导体（上海）股份有限公司 关于制定《员工购房免息借款制度》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据最新的《上海证券交易所科创板股票上市规则》，为员工提供购房免息借款属于财务资助事项，需上董事会审议。为便捷实际操作，晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了制定《员工购房免息借款制度》的议案，同意公司使用总额度不超过人民币3,000万元的自有资金为符合条件的员工提供购房借款，员工的借款总额在额度范围内可无需董事会逐笔审批，并同时制定《员工购房免息借款制度》。

本事项不会影响公司正常业务开展及日常资金周转需要，不构成关联交易，不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。本事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、财务资助事项

1、借款用途及额度：公司为员工提供购房借款的总额度不超过人民币 3,000 万元，每年借款总额度限额为人民币 1,000 万元，该额度使用后员工归还的借款及尚未使用额度将循环用于借款限额内后续公司员工购房借款申请。

2、借款金额：依据员工的职级类别、服务年限等评定出个人购房借款额度，最高不超过人民币 100 万元。

3、借款期限：借款期限最长为 36 个月。

4、借款担保：就购房免息借款事项，员工需要提供担保人，担保人可以为员工的父母、成年子女或其他有偿还能力的人。

5、还款方式：根据借款协议约定的还款时间和金额，由借款人授权公司人力资源部门，每月从其工资中抵扣每月应还款金额，具体金额及还款细节在《员

工购房免息借款协议》和《扣款授权书》中明确。

二、被资助对象的基本情况

被资助对象必须为在公司及其在中国区的分子公司连续服务满3年（含）以上的在职员工，公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员及其关联人和公司认定的核心技术人员不在此制度范围内，相关政策另行制定。关联人是指前述人士关系密切的家庭成员，包括配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

三、风险防范措施

公司为员工购房提供免息借款，建立了明确的制度，并充分考虑了员工的履约能力等因素，风险可控，具体风险防范措施主要包括：

1、公司制定了《员工购房免息借款制度》，对员工借款资格、操作流程、借款额度和还款计划等进行了具体规定。

2、公司与借款人签署《员工购房免息借款协议》，明确还款计划、担保条款、双方权利义务及违约责任等，有效降低风险。

四、董事会审议情况

公司于2025年9月5日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了制定《员工购房免息借款制度》的议案。

经审议，董事会同意公司使用总额度不超过人民币3,000万元为符合条件的员工提供购房借款，员工的借款总额在额度范围内可无需董事会逐笔审批。

《员工购房免息借款制度》符合公司实际情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。董事会一致同意公司向员工提供购房借款并制定《员工购房免息借款制度》。

五、累计提供财务资助金额及逾期金额

公司《员工购房免息借款制度》生效后，公司对员工购房借款总额度为人民币3,000万元，占公司2024年度经审计归属于公司股东净资产的0.47%。截至本公告披露日，公司不存在逾期未收回财务资助的情形。

特此公告。

晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会

2025年9月6日